



株式会社フェローテックホールディングス

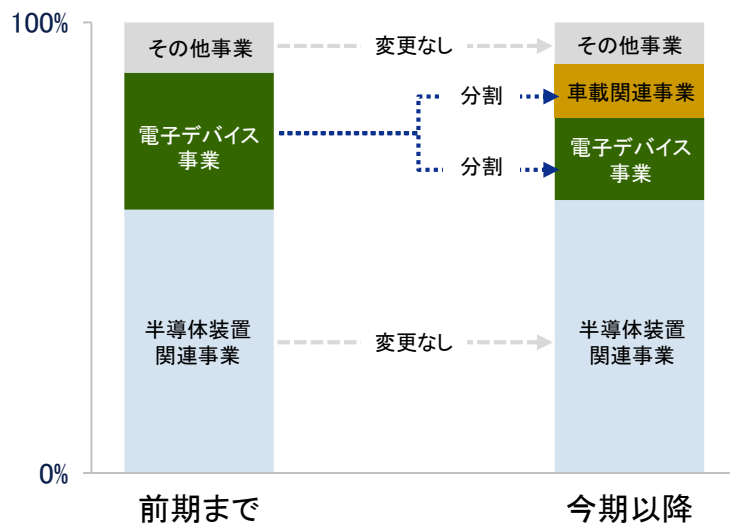
2025年3月期 決算説明

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2024年1月～2024年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、25/3期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

ご参考: セグメント変更に伴う過年度の遡及修正について

- ・ 今期からの車載関連事業セグメント追加に伴い、前期の一部セグメント数値を遡及修正
- ・ 製品用途を軸に、従来の電子デバイスセグメント事業の数値を、電子デバイス事業と車載関連事業に分割

前期数値の遡及修正に伴う売上高のイメージ



【詳細】

- ・ 今期より車載関連セグメントを新設
- ・ 車載関連セグメントは従来の電子デバイス事業に含まれていた「サーモモジュール」、「パワー半導体基板」、「センサ」のうち、用途が車載関連となるものを計上
- ・ 今期以降、従来の電子デバイス事業の数値は車載関連と電子デバイス事業に分割されることとなるため、当資料では比較基準を統一するため、前期資料を遡及修正
- ・ 修正に伴い、前期の電子デバイス事業の数値は大きく変動しております

*遡及修正は前期のみであり、23/3期以前は修正を行っておりません

業績総括

- 25/3期連結売上高は2,744億円、前期比+23%、営業利益は241億円、同△3%
- 半導体等装置、電子デバイス、車載の各SGの売上伸長、AI関連向けのサーモモジュール等好調
- PV向け坩堝・PVウエーハ受託生産の収益悪化及び生産拠点の新增設コスト負担あり、営業減益

半導体等関連

- マテリアルは特にセラミックス売上が前期比+36%と増進、顧客在庫の影響からシリコンパーツは軟調、石英は機械加工品軟調を火加工品でカバー
- 金属加工は中国需要も取込み前期比+49%、新規品製造・投資負担により収益率は低下
- 石英坩堝が前期はPV向け増加で利益貢献大も、今期は需要低迷しセグメント利益悪化要因に

電子デバイス・ 車載

- サーモモジュールは生成AI関連が引続き増勢
- パワー半導体基板は需要調整局面にて成長鈍化も、基板材料内製化、中長期成長予想、ジョホール工場が2025年4月に稼働開始
- センサは麗水等生産体制整備、営業活動強化、成長戦略を推進

株主還元等

- 株主還元方針の変更(3/19):DOE(連結株主資本配当率)を採用し、下限を3.5%に設定。
自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す
- 2025/3期配当は前期100円→141円に増配

連結決算サマリー

(百万円)	24/3期	25/3期	前期比	
	金額	金額	金額	増減率(%)
売上高	222,430	274,390	51,960	23.4
売上原価	152,573	201,029	48,455	31.8
売上総利益	69,856	73,361	3,504	5.0
販売管理費	44,984	49,271	4,287	9.5
営業利益	24,872	24,089	△ 782	△ 3.1
営業外収益	8,002	10,318	2,315	28.9
営業外費用	6,337	8,850	2,512	39.7
経常利益	26,537	25,558	△ 979	△ 3.7
特別利益	754	350	△ 404	△ 53.6
特別損失	1,145	862	△ 283	△ 24.7
非支配株主に帰属する当期純利益	5,481	3,607	△ 1,874	△ 34.2
親会社株主に帰属する当期純利益	15,154	15,692	538	3.6
設備投資額*	75,227	51,776	△ 23,451	△ 31.1
減価償却費	16,398	23,672	7,273	44.4
為替レート(期中平均)	米ドル: 141.20円 人民元: 19.87円	米ドル: 154.24円 人民元: 21.12円	—	—

売上高: 前期比+23.4%
 売上総利益: 前期比+5.0%
 販管費: 前期比+9.5%
 営業利益: 前期比△3.1%、△7.8億円
 各セグメントで売上増加も営業利益減少
 ・工場新增設等による減価償却費増(+72.7億円)、
 立上げコスト負担
 ・半導体等装置関連のPV向け石英坩堝の市況低迷、
 前期から一転収益悪化
 ・車載のパワー半導体基板は需要調整局面にあり
 収益性低下

営業外収益: 前期比+23.2億円(補助金収入+18.0億
 円、為替差益+3.2億円)
 営業外費用: 前期比+25.1億円(ウエーハ等持分法損失
 +16.8億円、支払利息+9.8億円)
 特別利益: 3.5億円
 特別損失: 8.6億円(PVウエーハ休止により、特損7.8億
 円に加え原価として棚卸資産評価減3.4億円)
 非支配株主持分利益: 36.1億円
 (シリコンパーツ・石英坩堝事業: 6.3億円/パワー半導体
 基板事業: 23.8億円/洗浄事業: 11.1億円/
 再生ウエーハ事業: △7.5億円)

*設備投資額＝有形固定資産、無形固定資産の取得額の合計

セグメント別売上高および営業利益

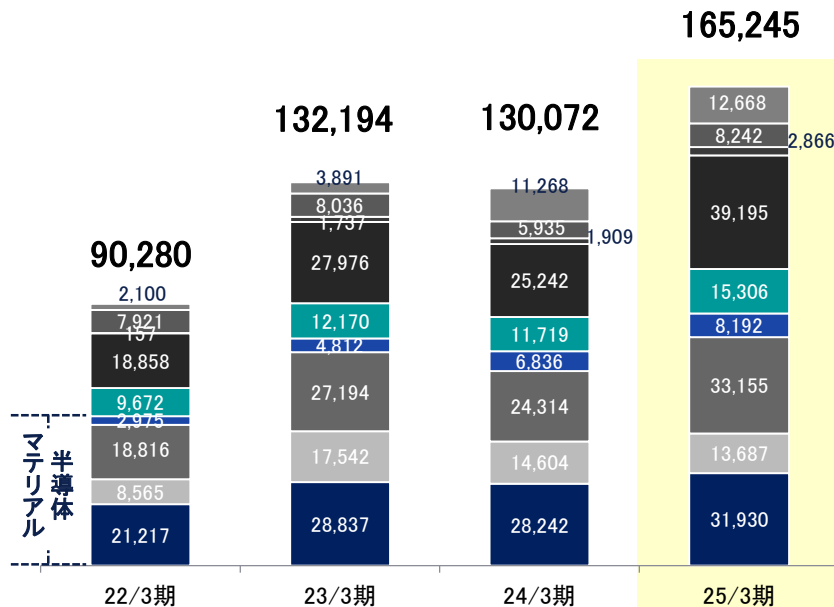
売上高 (単位:百万円)	24/3期		25/3期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	130,072	58.5	165,245	60.2	35,172	27.0
電 子 デ バ イ ス	41,727	18.8	50,487	18.4	8,759	21.0
車 載 関 連	25,872	11.6	30,463	11.1	4,591	17.7
そ の 他	24,757	11.1	28,194	10.3	3,436	13.9
合 計	222,430	100.0	274,390	100.0	51,960	23.4

営業利益 (単位:百万円)	24/3期		25/3期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	16,260	12.5	12,305	7.4	△ 3,954	△ 24.3
電 子 デ バ イ ス	6,829	16.4	8,250	16.3	1,420	20.8
車 載 関 連	4,060	15.7	3,599	11.8	△ 460	△ 11.4
そ の 他	△1,197	—	843	3.0	2,041	—
全 社 消 去	△1,080	—	△909	—	170	—
合 計	24,872	11.2	24,089	8.8	△ 782	△ 3.1

セグメント詳細: 半導体等装置関連セグメント

売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工・再生ウェーハ
- 石英坩堝
- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン



セグメント総括

- ・ 米国需要は概ね回復傾向も、製品により顧客在庫影響有、中国需要の新規品取込み売上増加
- ・ 工場新增設や新規取引開始の立上げコスト負担あり
前期比営業減益の主因はPV向け石英坩堝の収益減

真空シール・金属加工、再生ウェーハ

- ・ 真空シール・金属加工+140億円: 中国半導体装置関連の需要取込み大幅増、開始時コスト負担あり

半導体マテリアル、洗浄事業、石英坩堝

【半導体マテリアル（石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）】

- ・ 石英 +37億円: 顧客在庫影響あるが、中国顧客、火加工需要を取込みの売上増加
- ・ シリコンパーツ △9億円: 顧客在庫影響大きく売上減
- ・ セラミックス+88億円: 米国需要堅調、中国需要も増加し、牽引
- ・ CVD-SiC +14億円: 岡山工場の能力増が貢献し売上増加

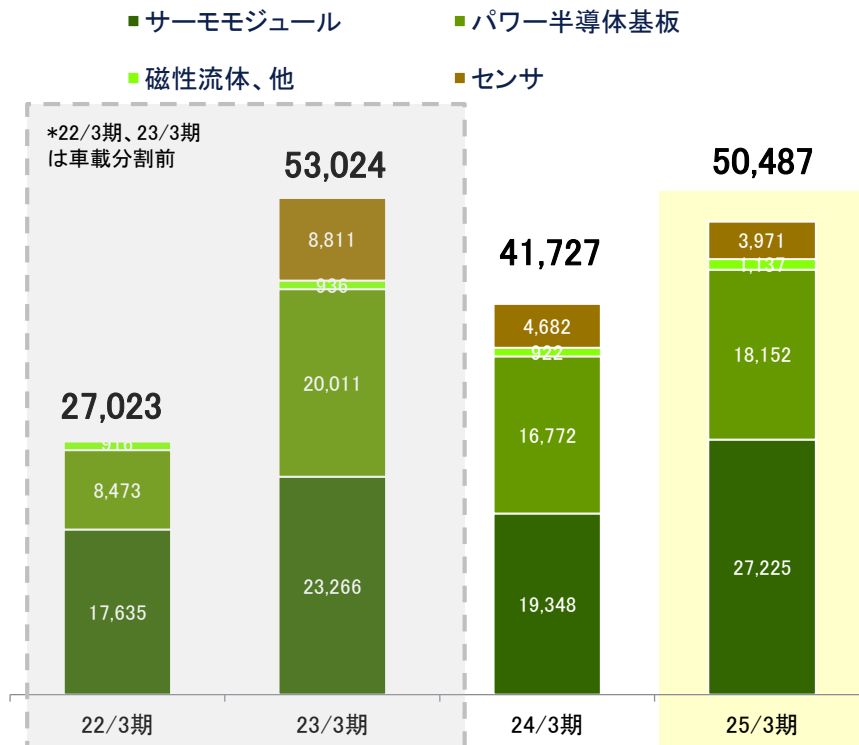
【洗浄事業】

- ・ 前期比+36億円: 中国半導体・液晶工場の稼働が順調に回復

【石英坩堝】

- ・ 前期比+14億円: PB向け需要急減・収益悪化、PV向け縮小へ

売上高の推移



セグメント総括

- ・ サーモジュールはAI関連向けが貢献し増加継続
- ・ パワー半導体基板は需要調整局面にて成長鈍化も増加継続
- ・ センサは大泉製作所の決算期変更影響で減

製品別

【サーモジュール】

- ・ 前期比+79億円：生成AIサーバー投資関連の光トランシーバー向けマイクロモジュールが売上・収益を牽引

【パワー半導体基板】

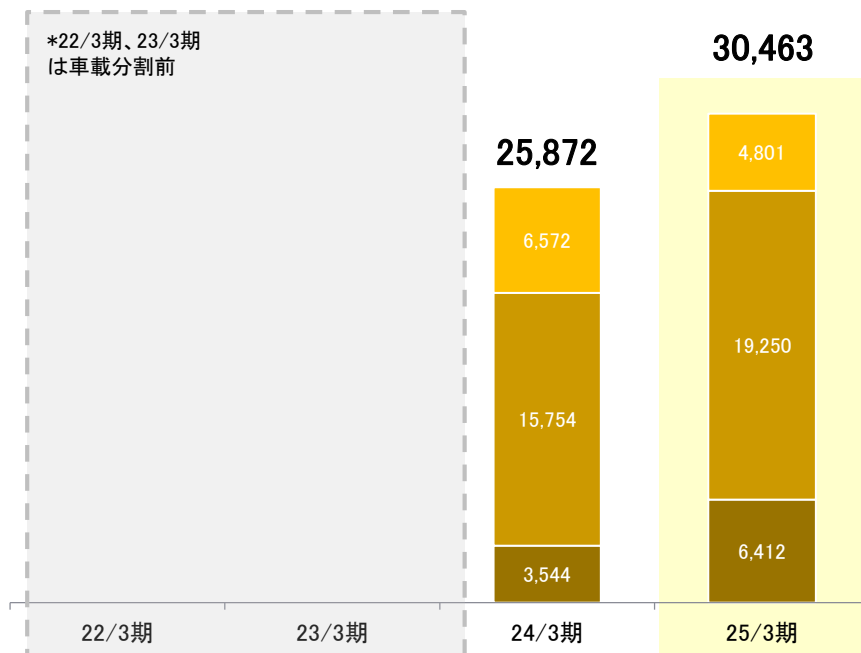
- ・ 前期比+14億円：産業機械向け増加等により売上増加

【センサー】

- ・ 大泉製作所決算期変更(3月→12月)影響で9か月決算

売上高の推移

■ サーモモジュール ■ パワー半導体基板 ■ センサ



セグメント総括

- ・ パワー半導体基板は、AMB基板伸長が貢献し売上増加
- ・ サーモモジュールは中国EV向け製品も貢献し売上増加
- ・ センサは大泉製作所の決算期変更影響で減

製品別

【サーモモジュール】

- ・ 前期比+29億円: 中国EV車向け車載冷蔵庫、カップホルダー拡販、温調シートも増

【パワー半導体基板】

- ・ 前期比+35億円: AMB基板が増加も、需要は調整局面、収益性は低下

【センサー】

- ・ 前期比 △ 18億円: 大泉製作所決算期変更影響

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	24/3期 期末	25/3期 期末	増減額
流動資産	248,408	295,367	46,959
現金及び預金	117,254	117,727	472
受取手形及び売掛金	61,940	92,608	30,667
たな卸資産	56,909	72,078	15,168
固定資産	261,618	305,226	43,608
有形固定資産	201,339	245,064	43,724
建物及び構築物	66,583	90,505	23,921
機械装置及び運搬具	59,533	87,549	28,015
工具、器具及び備品	7,468	8,637	1,168
土地	4,660	4,669	8
リース資産(純額)	12,018	14,852	2,834
建設仮勘定	51,075	38,850	△ 12,225
無形固定資産	6,611	6,166	△ 445
のれん	2,010	1,861	△ 149
投資その他資産	53,666	53,996	330
資産合計	510,026	600,593	90,567

【流動資産の主な増加要因等】

- ・受取手形・売掛金+307億円
- ・たな卸資産+152億円
期末前の売上増加等から売上債・在庫水準増加
- ・現預金 +5億円
残高1,177億円の内半分程度は洗浄、パワー半導体基板、
麗水センサ等の外部出資ある会社、増資資金等

【有形固定資産、無形固定資産の主な増加要因等】

- ・有形固定資産+437億円：
(マレーシアFTMM+85億円、マレーシアパワー半導体基板
+92億円、常山セラミックス等+35億円、麗水センサ+50億円、
日本FTMT・FTHD+61億円等)

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	24/3期 期末	25/3期 期末	増減額
流動負債	122,148	151,750	29,602
支払手形及び買掛金	38,334	55,394	17,059
短期借入金	26,454	34,482	8,028
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	21,022	24,592	3,570
固定負債	109,712	125,292	15,580
社債	320	—	△320
転換社債型新株予約権付社債	25,000	25,000	—
長期借入金	62,364	78,222	15,858
負債合計	231,860	277,043	45,183
純資産	278,166	323,549	45,383
株主資本	177,638	188,595	10,957
その他の包括利益累計額	26,771	48,235	21,464
非支配株主持分	73,756	86,718	12,961
負債・純資産合計	510,026	600,593	90,566
自己資本比率	40.1%	39.4%	△0.7pt
為替レート(期末レート)	米ドル:141.83円 人民元:19.93円	米ドル:158.18円 人民元:21.67円	—

【流動負債、固定負債の主な変動要因等】()内は前期末比

- ・ 短期借入+1年内長借・社債 591億円 (+116億円)
- ・ 長期借入+社債・転換社債 1,032億円 (+159億円)
- ・ 有利子負債 合計 1,623億円 (+275億円)

【純資産の主な変動要因等】

- ・ 株主資本 +110億円(利益剰余金+106億円)
- ・ その他の包括利益累計額 +215億円
(為替換算調整勘定 +215億円)
- ・ 非支配株主持分 +130億円
(パワー半導体基板 +45億円、シリコンパーツ・坩堝 +21億円、洗浄+25億円)

【自己資本比率】

- ・ 自己資本比率 39.4%

キャッシュフロー計算書

(百万円)	24/3期	25/3期
営業活動によるキャッシュフロー	28,720	26,066
税金等調整前四半期純利益	26,146	25,046
減価償却費	16,398	23,672
為替差損益(△:益)	△ 798	△ 643
売上債権の増減(△:増加)	△ 4,919	△ 22,550
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 5,177	△ 10,500
仕入債務の増減(△:減少)	△ 4,472	11,684
持分変動損益(△:益)	△ 710	△ 349
その他	2,254	△ 292
投資活動によるキャッシュフロー	△ 92,400	△ 39,627
有形固定資産取得による支出	△ 74,489	△ 51,239
有形固定資産の売却による収入	259	238
無形固定資産の取得による支出	△ 737	△ 537
投資有価証券の取得による支出	△ 2,098	△ 1,136
その他	△ 15,333	13,047
財務活動によるキャッシュフロー	60,419	18,965
短期借入金の増減額	5,314	6,360
長期借入れによる収入	57,734	39,593
長期借入金の返済による支出	△ 16,860	△ 19,102
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	24,898	-
非支配株主からの払込みによる収入	5,183	2,997
その他	△ 15,850	△ 10,883
現金及び現金同等物の増加額	901	12,092
現金及び現金同等物の期首残高	95,905	96,806
現金及び現金同等物の期末残高	96,806	108,899

【営業CFの状況】

- ・減価償却費: 237億円、前期比+73億円
マレーシアFTMM、常山新工場(セラミックス等)償却費増
- ・売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減: △214億円

【投資CFの状況】

- ・有形固定資産の取得: △512億円
- ・定期預金純増減 139億円

【財務CFの状況】

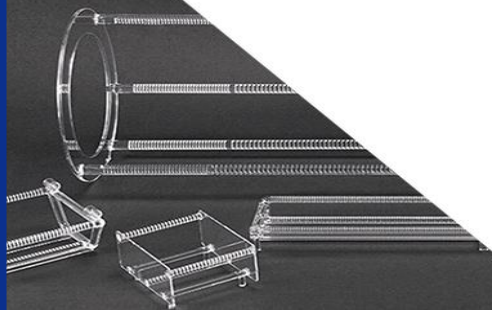
- ・長期借入による収入: 396億円
- ・非支配株主からの払込み: 30億円(麗水センサ30億円)



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



2026年3月期 通期業績予想



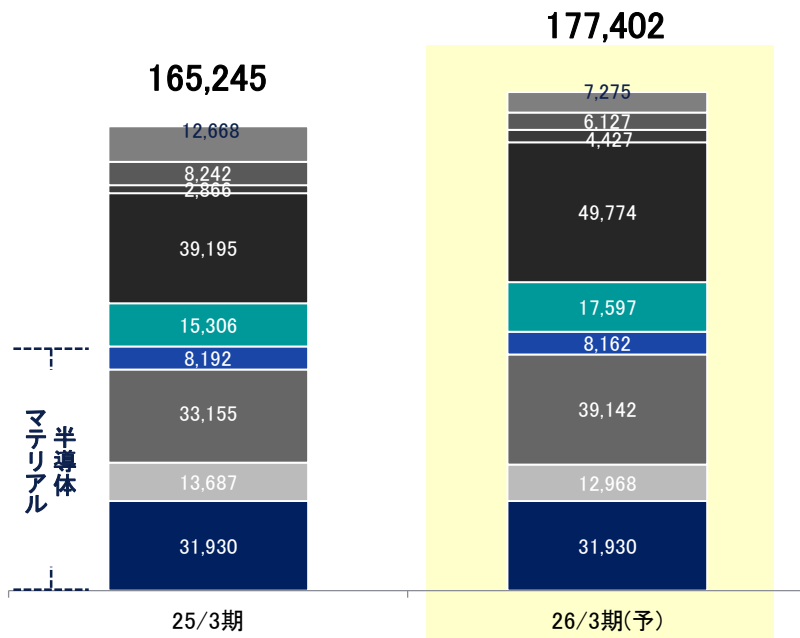
26/3期 通期業績予想

(百万円)	25/3期	26/3期(予)	前期比(%)	計画の詳細・前提
売上高	274,390	285,000	3.9%	・半導体関連のVF、セラミックスは増収継続、石英、シリコンパーツ等は顧客在庫要因の継続を想定 石英坩堝はPV向け抑制し規模縮小、損益は改善
営業利益	24,089	28,000	16.2%	・電子デバイスはTEの需要堅調、業績牽引 ・減価償却費が前期237億円→270億円に増加もマレーシアFTMM立上げ・黒字化、営業増益予想
経常利益	25,558	26,000	1.7%	・補助金収入は前期53億円→37億円へ減少予想 ・為替差益(前期17億円)を織込まず 経常利益横這い
親会社に帰属する当期純利益	15,692	16,000	2.0%	・特別損益の発生は予定せず
減価償却費	23,672	27,000	14.1%	・新增設工場立上げにより減価償却費が増加
EBITDA	47,761	55,000	15.2%	—
設備投資額	51,776	65,000	25.5%	マレーシアFTMM投資、マレーシアパワー半導体基板、常山セラミックス・CVD-SiC等投資
想定為替レート(期中平均)	米ドル: 152.24円 人民元: 21.12円	米ドル: 146円 人民元: 20円	—	下期円高予想も事業会社12月決算のため本水準

セグメント詳細: 半導体等装置関連セグメント

売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工・再生ウェーハ
- 石英坩堝
- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン



セグメント総括

- ・ 真空シール・金属加工、セラミックス、洗浄は売上増進
石英、シリコンパーツは顧客在庫要因継続を想定
- ・ 石英坩堝はPV向け抑制し売上減・損益改善を予想

真空シール・金属加工、再生ウェーハ

- ・ 真空シール・金属加工+68億円: 米国向け回復基調、中国向け引き続き堅調

半導体マテリアル、洗浄事業

【半導体マテリアル (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】

- ・ 石英+0億円: 顧客在庫影響の継続を想定
- ・ シリコンパーツ△7億円: 顧客在庫の影響大
- ・ セラミックス+60億円: 米国向け回復基調、中国向け増進
- ・ CVD-SiC △0億円: 横這い予想も引合いは強く、キャパ増強継続

【洗浄事業】

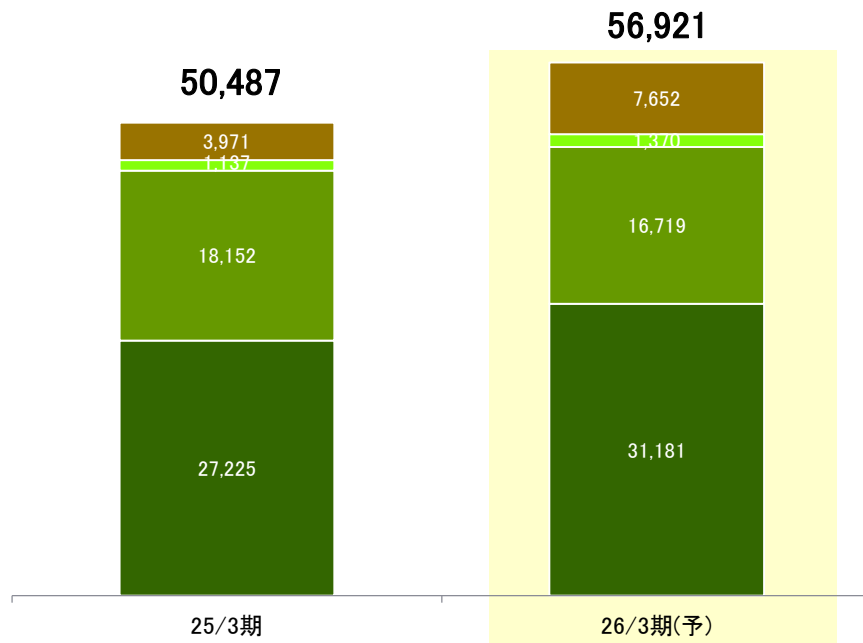
- ・ 前期比+23億円: 中国における半導体生産堅調

【石英坩堝】

- ・ 前期比-54億円: PV向け抑制、半導体向け中心へ

売上高の推移

- サーマモジュール
- パワー半導体基板
- 磁性流体、他
- センサ



セグメント総括

- ・ サーマモジュールがAI関連向け増加継続し牽引
- ・ センサは売上回復見通し及び前期決算期変更の影響

製品別

【サーモモジュール】

- ・ 前期比+40億円、AI関連需要の増加が継続

【パワー半導体基板】

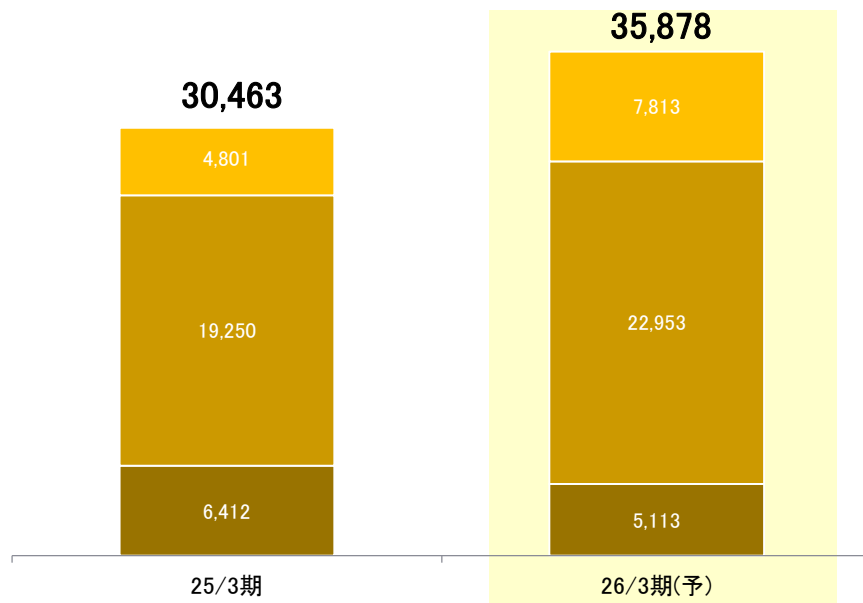
- ・ 前期比△14億円: 中期的な成長見通しは不変だが、足許では需要回復を織込まず

【センサー】

- ・ 前期比+37億円: 売上回復見通し及び前期は決算期変更から9カ月決算であった影響

売上高の推移

■ サーモモジュール ■ パワー半導体基板 ■ センサ



セグメント総括

- ・ パワー半導体基板の引合いが堅調、売上増加を牽引
- ・ センサは売上回復見通し及び前期決算期変更の影響から増加

製品別

【サーモモジュール】

- ・ 前期比△13億円: 自動車温調シート向け等減少見通し

【パワー半導体基板】

- ・ 前期比+37億円: 新エネルギー車向け等引合い堅調

【センサー】

- ・ 前期比+30億円: 売上回復見通し及び前期は決算期変更から9カ月決算であった影響

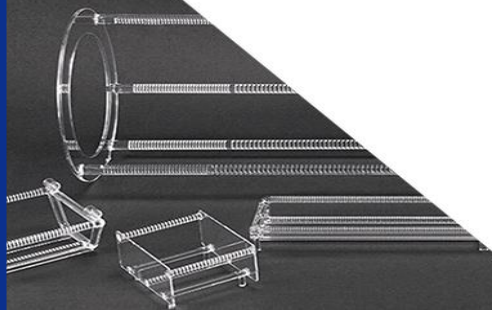


Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



中期経営計画のアップデート

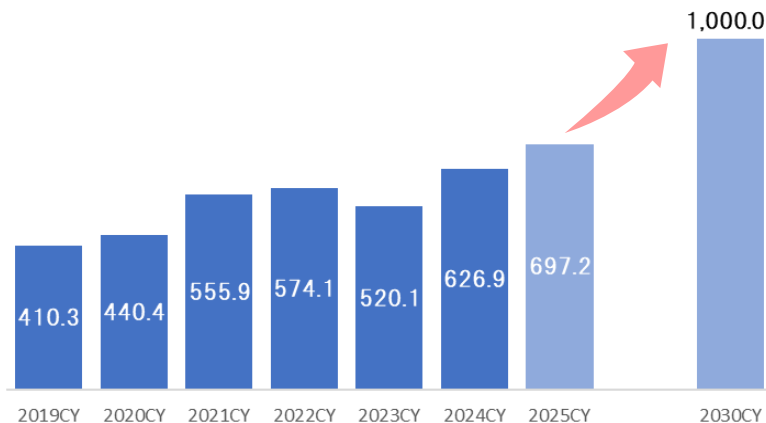
26/3期～28/3期



2025年の半導体市場は伸長も、WFEはほぼ横ばい

- WFEは中国向け輸出の減少等の影響で横ばい。米国における政策先行き見通せず足許は不透明も、中長期的には市場は伸長予測

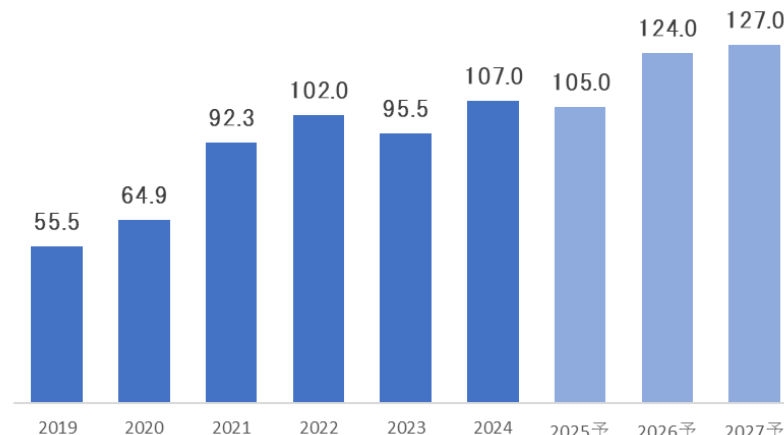
半導体市場予測



(10億米ドル)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
半導体需要	410.3	440.4	555.9	574.1	520.1	626.9	697.2
前年比成長率	-0.5%	+7.3%	+26.2%	+3.3%	-9.4%	+20.5%	+11.2%

※WSTS発表資料

WFE(半導体製造装置前工程)市場予測



(10億米ドル)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025予	2026予	2027予
WFE市場金額	55.5	64.9	92.3	102.0	95.5	107.0	105.0	124.0	127.0
前年比成長率	-6.0%	+16.9%	+42.2%	+10.5%	-6.4%	+12.0%	-1.9%	+18.1%	+2.4%

※某証券会社統計を一部加工

事業成長

- ・ 連結売上高2,744億円(前期比+23.4%)、営業利益241億円(前期比△3.1%)
半導体等装置、電子デバイス、車載の各SGの売上伸長、PV向け坩堝・PVウエーハ受託生産事業の収益悪化及び生産拠点の新增設コスト負担あり、AI関連向けのサーモモジュール等好調も営業減益
- ・ 麗水工場の新設等、センサ事業への投資を推進

生産効率・ 競争力強化

- ・ マレーシア・クリム工場(半導体関連)稼働開始、顧客認定進捗
- ・ マレーシア・ジョホール工場(パワー半導体基板)は4月に竣工、顧客引合い強い
- ・ 検査工程の自動化・AI化、倉庫や加工工程の自動化を実施、デジタル化・自動化が進捗
- ・ パワー半導体の基板材料開発、半導体セラミックスの製品レンジ拡大等が進展

人材・ 企業文化

- ・ 人材重視を重要な経営戦略と位置付け、幹部級の人材採用に注力、研修制度の拡充を実施
- ・ 「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を指針に掲げ、企業文化の浸透を実施

財務・ 株主還元等

- ・ 株主還元を強化、新たに3.5%を下限とするDOEを採用、また自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指していく方針とした
- ・ 中国上場の洗浄事業子会社FTSVAがパワー半導体基板子会社FLHを取得する計画を開示

資本コスト・株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの進捗

分類	項目	進捗
利益率	生産のデジタル化・自動化・AI化・見える化	検査の自動化・AI化、倉庫自動化等進捗 人員増加を抑制した生産増加を目指す
利益率、総資産 回転率等	事業の選択と集中(事業の売却や非連結化)	一部事業の非連結化等進捗(交渉段階) PVウエーハ受託生産停止、PV坩堝事業縮小
収益率、総資産 回転率等	事業別・会社別ROIC管理、投資コントロール、 運転資本の圧縮	ROIC月次管理実施、社内の浸透が進展 在庫・運転資本の月次管理・削減推進を実施
財務レバレッジ 等	新工場の早期稼働によるキャッシュフロー改善	クリム工場早期稼働に注力、月次黒字化 ジョホール工場は4月竣工
財務レバレッジ	資金調達の多様化	中国上場の洗浄事業子会社(FTSVA)がパワー 半導体基板子会社(FLH)を取得
資本コスト	自社株買い等株主還元の多様化の検討 サステナビリティ活動、IR活動強化	株主還元を強化、3.5%下限のDOEを採用 グループGHG(CO2)排出測定を実施
EPS期待成長率	米中摩擦に対応した中国外製造拠点の拡充	クリム工場の稼働開始、顧客認定進捗 米国顧客等の要請に対応、クリム第二工場着工

事業成長

- ・ 半導体関連、電子デバイス、自動車関連事業を拡大し、成長を追求する
- ・ 米中摩擦による中国外製造(Ex-China)のニーズに対応してマレーシア等の中国外製造を強化しながら、中国における半導体関連ニーズの取込みを進める

収益性向上・ 生産効率向上

- ・ マレーシア(クリム、ジョホール)工場の生産拡充・効率性向上による収益率の引上げ実現
- ・ デジタル化・自動化・AI化を展開し、生産効率向上・競争力強化を追求する
- ・ 新製品・新技術の開発を推進・強化、「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続

人材・ 企業文化

- ・ 人材重視を重要な経営戦略とし、人材の採用及び育成を推進
- ・ 企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」指針の浸透活動を継続する

財務・ 株主還元等

- ・ 中国上場の洗浄事業子会社FTSVAとパワー半導体基板子会社FLHの統合実現後には株式時価が増加見通しであり、活用方法を検討する
- ・ 新たな株主還元方針に則り、DOEを採用、自社株式の取得も機動的に検討する方針

工場立上げの進捗 – マレーシア・クリム工場

- マレーシア・クリム第一工場は24年1月竣工。顧客認定が順調に進み、2025年1Qに月次損益で黒字化を達成、2025年に生産拡充・効率化向上による収益強化を見込む
- 米中半導体摩擦を受け、米国顧客等から生産増強の要請を受け、第二工場建設を決定

対象事業	対象事業	2025	2026	2027	2028	2029	現在の生産能力 (億円)	最大生産能力 想定(億円)
マレーシア クリム第一工場	金属加工 石英 セラミックス 装置組立	本格生産 フル稼働					150	190
マレーシア クリム第二工場		稼働開始 本格生産 フル稼働					0	240



クリム第一工場 (マレーシア)



クリム第二工場 完成予想図_鳥観図(マレーシア)

工場立上げの進捗 – パワー半導体基板

- ・ パワー半導体基板、中国内江工場は2023年7月竣工、2023年4Qに少量生産開始
- ・ マレーシア・ジョホール工場は2024年4Q設備搬入開始、2025年1月試生産開始、3月初出荷

対象事業	対象事業	2025	2026	2027	2028	2029	現在の生産能力 (億円)	最大生産能力 想定(億円)
パワー半導体 基板	中国 東台・内江	本格生産 フル稼働					570	600
パワー半導体 基板	マレーシア	稼働開始 本格生産 フル稼働					70	130



内江工場(中国四川)

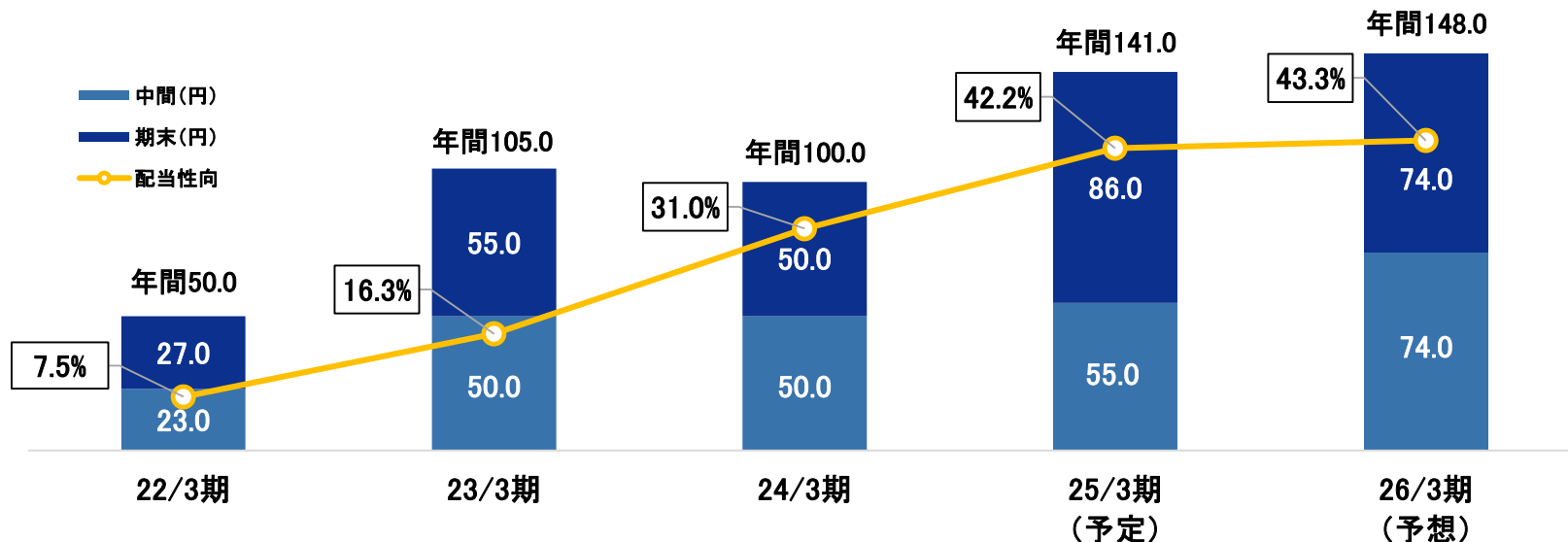


ジョホール工場(マレーシア)

- 【株主還元方針】3月19日に株主還元方針を見直し

株主還元の強化を図るため、新たにDOE(株主資本配当率)を採用し下限を3.5%設定、持続的な収益増強により配当水準の引上げを目指すとともに、財務の状況等を考慮しながら、自社株式の取得を機動的に検討し、総還元性向は50%を目指して充実を図っていく

1株当たり配当金の推移



- 3か年の設備投資は累計1,400億円を計画
- 26/3期～28/3期、500億円以上のグループ資産(子会社株式等)を売却する方針
- 売却代金は、設備投資資金や自己株式の取得を含む株主還元に充当する予定

26/3期～28/3期設備投資計画

- 設備投資総額: 1,400億円

(主要案件)

マレーシアクリム第一工場機械設備投資

マレーシアクリム第二工場投資

マレーシアジョホール工場投資

中期経営計画KPI(ローリングアップデート)

- ・ 足許の半導体関連需要の成長減速や投資等を織込み、中期計画を見直し

(金額の単位は百万円)	25/3期(実)	26/3期(予)	27/3期(計)	28/3期(計)
売上高	274,390	285,000	340,000	400,000
営業利益	24,089	28,000	35,000	47,000
営業利益率	8.8%	9.8%	10.3%	11.8%
当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000
ROE	7.1%			15%
ROIC*	3.9%			8%
自己資本比率	39.4%	40%		
設備投資	51,776	65,000	45,000	30,000
1株当たり配当金(年間)	141.0円	148.0円	DOE(連結株主資本配当率**)を採用し、下限を3.5%に設定 自社株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

*ROIC = 親会社帰属純利益 ÷ (有利子負債 + 純資産)、純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

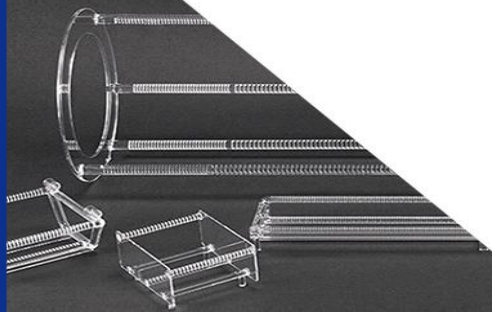
**連結株主資本 = 資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式、連結株主資本配当率 = 配当金総額 ÷ 連結株主資本



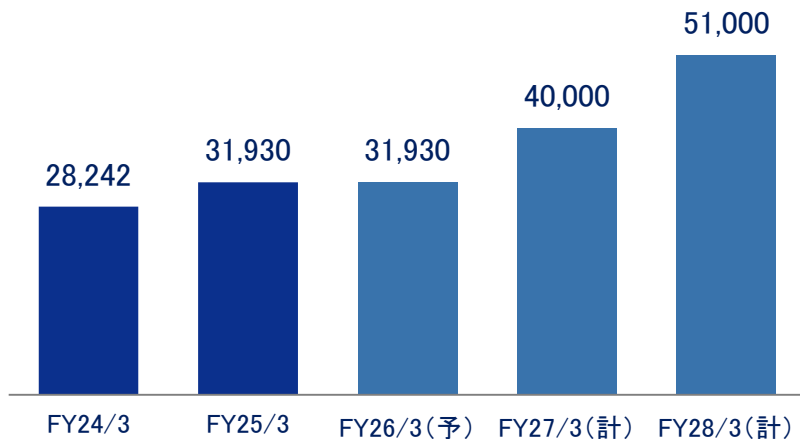
FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



注力製品別戦略



売上高の推移



常山2期工場(中国浙江)



総括

- 消耗材のスペア需要がユーザー在庫の影響から軟調、火加工品需要を取込み売上増加を図るも収益性は低下
- マレーシア・クリム第一工場の立上げは順調、黒字化達成
- デジタル化・自動化による効率化進展

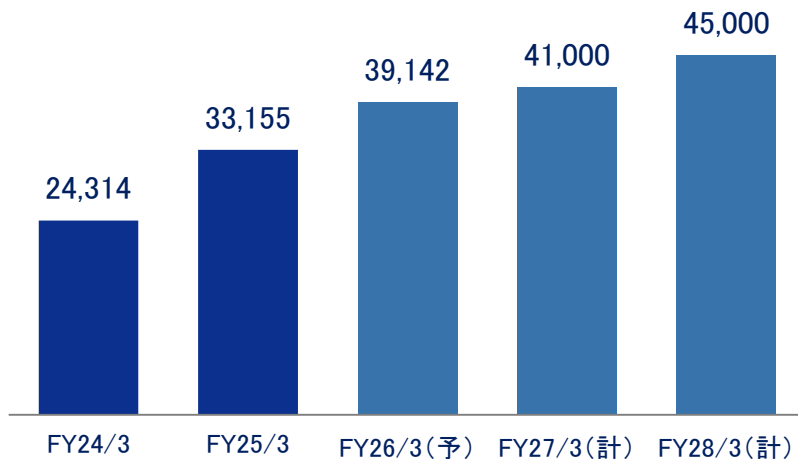
中長期業績見通し

- 欧米顧客は、ユーザー在庫の影響を2025年も一部残存を織り込み、回復本格化は2025年後半以降だが中期的な需要は拡大見通し
- クリム工場黒字化、生産拡充・効率性向上を進め、収益増強を進める

設備投資・生産能力の状況

- 欧米顧客の中期的な需要増加見通し、増産要請に対応し、クリム第二工場を着工
- 拡大する中国顧客需要を、中国内キャパにて対応する

売上高の推移



常山3期工場(中国浙江)



総括

- 需要堅調、中国市場の成長も貢献、売上拡大
- マレーシア・クリム第一工場の立上げは順調、黒字化達成
- デジタル化・自動化による効率化進展

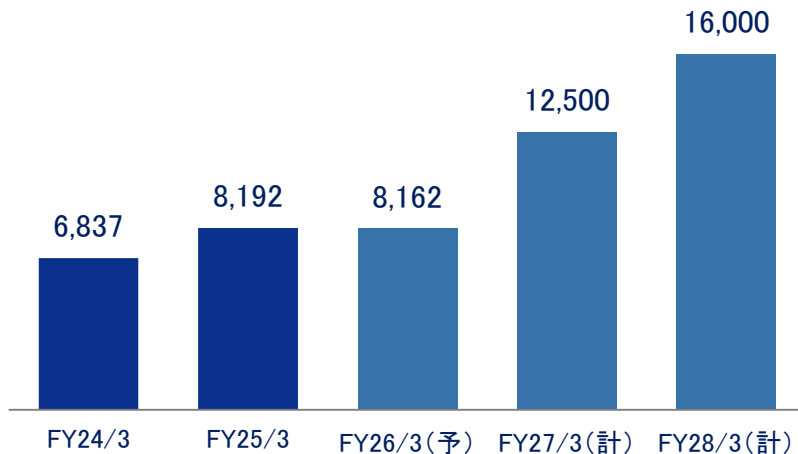
中長期業績見通し

- 欧米顧客の需要は2025年後半に増加見通し、中期的な需要は拡大見通し
- 中国市場も中期的には拡大見通し

設備投資・生産能力の状況

- 欧米顧客の中期的な需要増加見通し、増産要請に対応し、クリム第二工場を着工
- 中国顧客需要を、中国内キャパにて対応する

売上高の推移



常山3期工場(中国浙江)



総括

- 岡山工場のキャパ拡充により需要取込み、売上増加トレンド継続
- 常山工場立上げ中

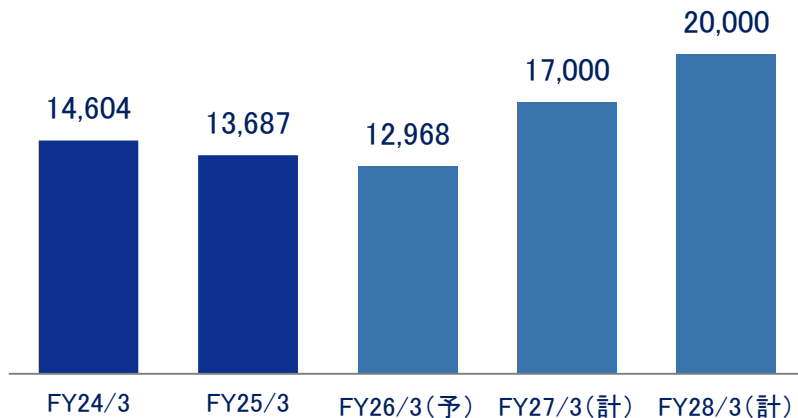
中長期業績見通し

- CVD-SiCは需要拡大が継続する見通し
- 岡山工場のキャパ拡充、常山工場の立上げにより、売上拡大を図る

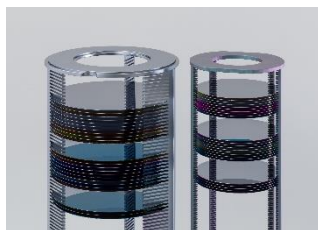
設備投資・生産能力の状況

- 常山工場の生産ライン立上げ中、生産キャパを引上げ、更なる需要取込みを図っていく

売上高の推移



常山3期工場(中国浙江)



総括

- ・ユーザー在庫の影響大きく、2024年売上は前期比減少
- ・デジタル化・自動化による効率化進展

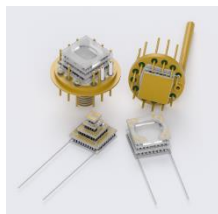
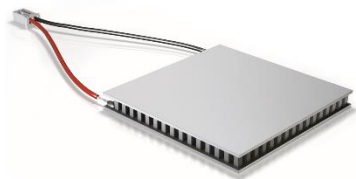
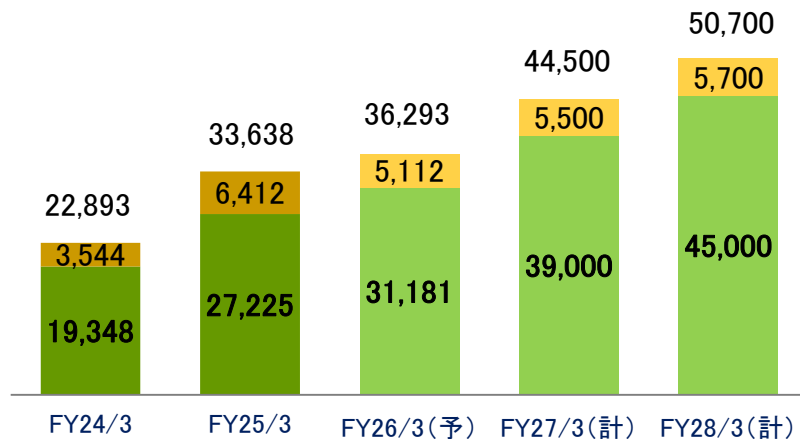
中長期業績見通し

- ・ユーザー在庫の影響継続を織り込み、回復本格化は2026年以降
- ・中長期の需要は底堅い見通し

設備投資・生産能力の状況

- ・欧米顧客の中国外製造ニーズに応え、2025年にマレーシア・ジョホール工場立ち上げ中、下期生産開始予定(建屋賃借)

売上高の推移



総括

- AI関連需要が牽引、売上成長が継続
- 検査のAI化・自動化、自動化倉庫等による収益性強化が進展

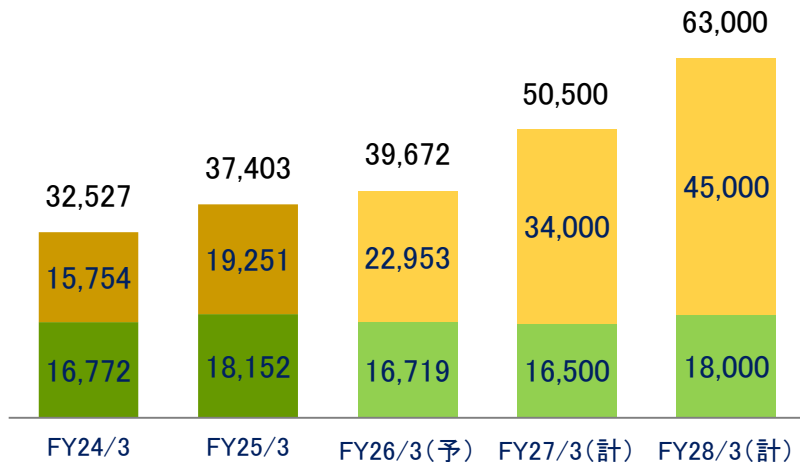
中長期業績見通し

- AI関連需要の取込みにより成長継続を見込む
- 冷却チラー事業の拡充目指す

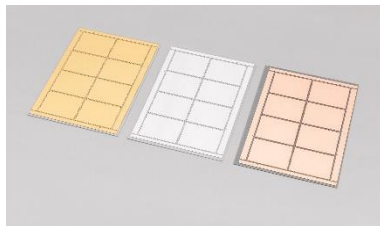
設備投資・生産能力の状況

- 生産の自動化・効率化は更に進める
- 中国外製造は検討

売上高の推移



内江工場(中国四川)



総括

- パワー半導体マーケットの需要調整局面において売上成長に一服感あるが、市場シェアは引上げ
- 基板材料の内製化、検査のAI化・自動化や自動化倉庫等による収益性強化を推進

中長期業績見通し

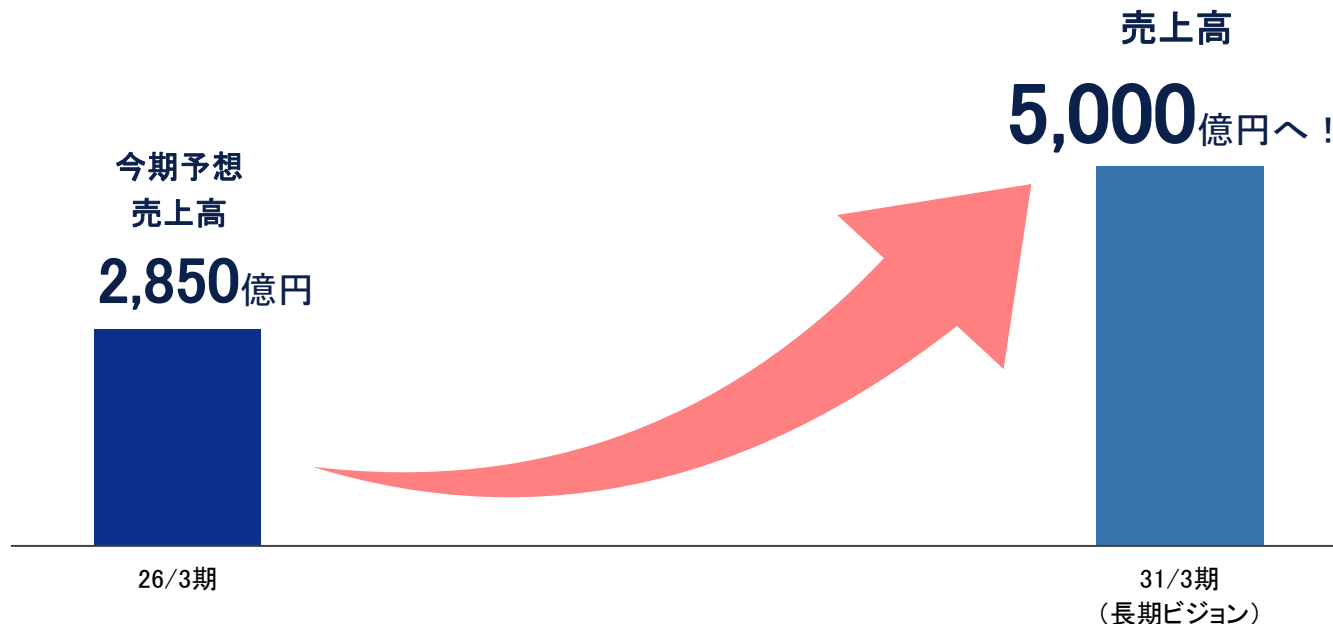
- パワー半導体基板の中長期的な需要は拡大基調が継続する見通し
- DPC等の製品レンジの拡充、材料内製化、自動化等により事業基盤の拡充を進める

設備投資・生産能力の状況

- 四川工場は生産拡充による収益貢献を見込む
- マレーシア・ジョホール工場は2025年4月生産開始、顧客需要は堅調であり、段階的に稼働が増加する見通し

長期業績目標は継続も、キャッシュフロー及びROE・ROIC向上を図りながら実現を図る

2030年度に売上高**5,000**億円 当期純利益**500**億円の達成を目指す！

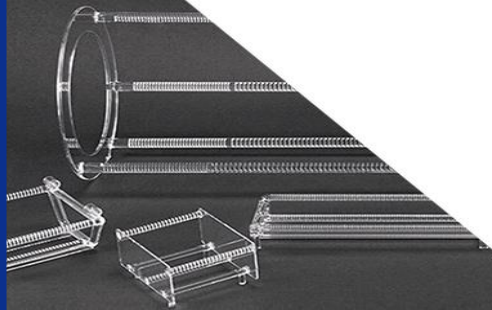




FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



25/3期 製品別売上高詳細(上期・下期)

(百万円)	24/3期 実績			25/3期 実績					
	通期	上期	下期	通期	前期比	上期	前年同期比	下期	前年同期比
半 導 体 等 装 置 関 連	130,072	60,257	69,814	165,245	27.0%	84,042	39.5%	81,202	16.3%
真空シール・金属加工	25,242	11,730	13,512	39,195	55.3%	19,347	64.9%	19,848	46.9%
石英製品	28,242	11,584	16,657	31,930	13.1%	16,134	39.3%	15,795	△ 5.2%
シリコンパーツ	14,604	7,712	6,892	13,687	△ 6.3%	7,172	△ 7.0%	6,514	△ 5.5%
セラミックス	24,314	11,657	12,656	33,155	36.4%	15,448	32.5%	17,707	39.9%
CVD-SiC	6,836	2,999	3,837	8,192	19.8%	3,992	33.1%	4,199	9.4%
EBガン・LED蒸着装置	5,935	3,011	2,923	8,242	38.9%	4,076	35.3%	4,166	42.5%
ウエーハ加工	129	43	86	10	△ 92.2%	10	△ 75.4%	△ 0	△ 100.5%
再生ウエーハ	1,780	752	1,027	2,856	60.5%	1,251	66.2%	1,605	56.3%
部品洗浄	11,719	5,424	6,294	15,306	30.6%	7,061	30.2%	8,245	31.0%
石英坩堝	11,268	5,341	5,927	12,668	12.4%	9,547	78.7%	3,121	△ 47.3%
電 子 デ バ イ ス	41,727	18,834	22,893	50,487	21.0%	23,085	22.6%	27,401	19.7%
サーモモジュール	19,348	8,844	10,504	27,225	40.7%	12,431	40.6%	14,794	40.8%
パワー半導体基板	16,772	7,245	9,526	18,152	8.2%	8,692	20.0%	9,460	△ 0.7%
磁性流体・その他	922	398	524	1,137	23.3%	575	44.3%	562	7.3%
センサ	4,682	2,344	2,338	3,971	△ 15.2%	1,387	△ 40.8%	2,584	10.5%
車 載 関 連	25,872	14,006	11,866	30,463	17.7%	14,304	2.1%	16,159	36.2%
サーモモジュール	3,544	1,795	1,748	6,412	80.9%	3,108	73.1%	3,304	89.0%
パワー半導体基板	15,754	8,857	6,896	19,250	22.2%	9,628	8.7%	9,621	39.5%
センサ	6,572	3,352	3,220	4,801	△ 27.0%	1,567	△ 53.2%	3,233	0.4%
そ の 他	24,757	12,396	12,361	28,194	13.9%	13,723	10.7%	14,470	17.1%
合 計	222,430	105,494	116,936	274,390	23.4%	135,157	28.1%	139,233	19.1%

26/3期 セグメント・製品別の業績予想(上期・下期)

(百万円)	25/3期 実績			26/3期 予想					
	通期	上期	下期	通期	前期比	上期	前年同期比	下期	前年同期比
半 導 体 等 装 置 関 連	165,245	84,042	81,202	177,402	7.4%	84,210	0.2%	93,192	14.8%
真空シール・金属加工	39,195	19,347	19,848	49,774	27.0%	24,395	26.1%	25,379	27.9%
石英製品	31,930	16,134	15,795	31,930	0.0%	15,634	△ 3.1%	16,296	3.2%
シリコンパーツ	13,687	7,172	6,514	12,968	△ 5.3%	6,485	△ 9.6%	6,483	△ 0.5%
セラミックス	33,155	15,448	17,707	39,142	18.1%	17,647	14.2%	21,495	21.4%
CVD-SiC	8,192	3,992	4,199	8,162	△ 0.4%	3,728	△ 6.6%	4,434	5.6%
EBガン・LED蒸着装置	8,242	4,076	4,166	6,127	△ 25.7%	2,737	△ 32.9%	3,390	△ 18.6%
ウエーハ加工	10	10	△0	0	-	0	-	0	-
再生ウエーハ	2,856	1,251	1,605	4,427	55.0%	2,137	71.0%	2,290	42.5%
部品洗浄	15,306	7,061	8,245	17,597	15.0%	8,247	16.8%	9,350	13.4%
石英坩堝	12,668	9,547	3,121	7,275	△ 42.6%	3,199	△ 66.5%	4,076	30.6%
電 子 デ バ イ ス	50,487	23,085	27,401	56,921	12.7%	27,150	17.6%	29,771	8.6%
サーモモジュール	27,225	12,431	14,794	31,181	14.5%	14,858	19.5%	16,323	10.3%
パワー半導体基板	18,152	8,692	9,460	16,719	△ 7.9%	8,680	△ 0.1%	8,039	△ 15.0%
磁性流体・その他	1,137	575	562	1,370	20.4%	608	5.7%	762	35.3%
センサ	3,971	1,387	2,584	7,652	92.7%	3,005	116.7%	4,647	79.8%
車 載 関 連	30,463	14,304	16,159	35,878	17.8%	16,338	14.2%	19,540	20.9%
サーモモジュール	6,412	3,108	3,304	5,113	△ 20.3%	2,539	△ 18.3%	2,574	△ 22.1%
パワー半導体基板	19,250	9,628	9,621	22,953	19.2%	10,546	9.5%	12,407	28.9%
センサ	4,801	1,567	3,233	7,813	62.7%	3,252	107.5%	4,561	41.0%
そ の 他	28,194	13,723	14,470	14,799	△ 47.5%	7,303	△ 46.8%	7,497	△ 48.2%
合 計	274,390	135,157	139,233	285,000	3.9%	135,000	△ 0.1%	150,000	7.7%

主な工場新設・生産能力増強の状況

- 成長へ向けて、工場の新・増設を着々と進め、生産能力を拡大中。以下は現時点の主な予定

対象事業	所在地	2025	2026	2027	2028	2029	現在の生産能力 (億円)	最大生産能力想定 (億円)
パワー半導体 基板	中国 東台・内江						570	600
パワー半導体 基板	マレーシア						70	130
セラミックス	日本 石川県						100	140
セラミックス シリコンパーツ	中国 常山						100	170
金属加工・石英 セラミックス	マレーシア						150	430
洗浄	日本 熊本県						0	20

マレーシア工場の建設

- 増加する需要に備え、マレーシア北部に第二工場の建設を決定
- 地政学的リスクの上昇に伴い増加する中国国外での生産ニーズへの取込みを図る



クリム第二工場 完成予想図(マレーシア)

マレーシア新工場の詳細

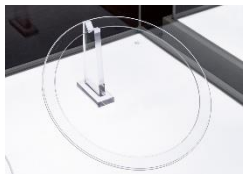
投資金額	2億2,640万ドル(約333億円)
製造品目	石英、セラミックス、金属受託加工
工場面積	敷地面積: 約80,900m ² 工場面積: 約90,800m ²
スケジュール	着工: 2025年4月 建屋完成: 2026年6月 操業開始: 2026年9月

設備投資の計画

	26/3期	27/3期	28/3期	29/3期	計
投資金額	45億円	156億円	106億円	26億円	333億円

半導体等装置関連セグメントの製品ラインアップ

半導体製造装置向け治具・消耗材(当社主力のマテリアル製品群)



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み: 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウェーハ)をラインアップ



真空シール

※半導体・FPD
製造装置部品



金属精密加工

※今後の中国国内顧客
(工場)増で伸長の見通し



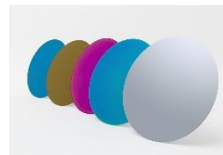
装置部品洗浄

※中国市場に特化



石英坩堝

※半導体・太陽電池向け



再生ウェーハ

※中国市場に特化

持分法適用関連会社での事業



シリコンウェーハ

※月産能力6インチ 40万枚、8インチ 45万枚
12インチ30万枚

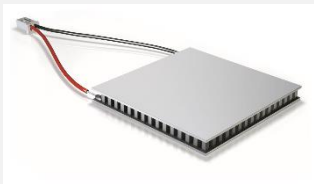


SiCウェーハ

※開発～量産化

電子デバイスセグメントの製品ラインアップ

サーモモジュール



自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中



チラー

チラー(恒温水循環装置)は、水などの循環する液体を予め設定した温度に冷却/加熱しながら供給する装置。設備や装置にある熱源などの対象物を一定の温度に保つことに用いられる

パワー半導体用絶縁基板



世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中（アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術）

パワー半導体のアプリケーション



磁性流体



自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中

温度センサ(サーミスタ) ※大泉製作所



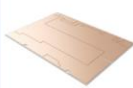
サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックス。車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化で需要拡大中

車載関連セグメントの製品

【主な製品】パワー半導体基板・アプリケーション

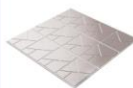
DCB基板

主にルームランプやAV・アクセサリ制御などのインバーター向けに使用されるパワー半導体ユニットに搭載される基板です。材質はアルミナセラミックス材質の基板を提供しています。



AMB基板

主にバッテリー制御やモーター制御などハイパワー用途で使用されます。窒化珪素・窒化アルミニウム材質で、主にSiC基板との組み合わせられる基板です。



【主な製品】サーミスタ・アプリケーション

サーミスタ

サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックスです。温度センサとして搭載され、エアコン、電池、燃料噴射など様々な制御を行うのに不可欠なパーツとなっています。



OHIZUMI

パワー半導体

ヘッドランプ制御
ルームランプ制御
AV・アクセサリ制御
ステアリング制御
モーター制御
トランスミッション制御
ブレーキ制御

サーミスタ

吸気エア専用
吸気エア通用
車内温度用
ディーゼル燃温用
ラジエーター水温用

サーモモジュール

レーザーレーダー

ヘッドアップディスプレイ

ADAS(先進運転支援システム)
GPU(画像処理装置)クーラー
CMOS(相補型金属酸化膜半導体)クーラー

レーザーヘッドライト

シートクーリングシステム
ステアリングヒーター/クーラー
クーラボックス
カップホルダー
ヒーター/エアコン

バッテリークーリング

【主な製品】サーモモジュール・アプリケーション

レーザーレーダー

レーザー光を対象物に照射して距離の計測や対象物の性質を特定します。サーモモジュールを用いることで熱の影響を抑制し測定精度を安定させます。



自動車用温調シート

運転席、助手席、後部座席シートを温めたり冷やしたりすることで、快適なドライブが可能になります。



クーラボックス

EV車は比較的車内の居住空間を広く確保できるため、クーラボックスを搭載する車種が増えています。現在メーカーとの共同開発を進めています。



カップホルダー

従来の車内にあるカップホルダーも、サーモモジュールを使用し、保温・保冷機能を持たせることで快適なドライブをサポートします。



IRポータルサイト「IRSTREET」にて、
当社のIRニューズを日英にて掲載・メールにて配信しております
ぜひ以下のURLよりご登録ください



■ 日本語でのご登録

[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=1&language=1&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)

■ 英語でのご登録

[https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select\[\]=85](https://ircms.irstreet.com/member_registration/new_u.php?site=2&language=2&brand_selection=0®ist_brand_select[]=85)

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

＜本件照会先＞

IR・広報部 03-3281-8186